

Model



GLP-150

難削材対応研削装置

Grinder for Superhard Materials

【概要 - Outline -】

◆難削材等ウエハー (LT、SiC、GaN、AL2O3 等) を高速で高精度に研削する装置です。

Grinding machine which capable to grind wafer of resistant materials(LT, SiC, AL2O3 etc) with high speed, high accuracy.

【特長 - Features -】

- ◆セル方式採用
Cell junction type
- ◆高剛性
High rigidity configuration
- ◆高速・高荷重・高精度
High speed, High load, High accuracy
- ◆圧倒的な TTV 向上※1
TTV improvement
- ◆選べる3つの加工モード
Three processing methods
- ◆トレーサビリティ
Traceability
- ◆省力化
Laborsaving
- ◆環境にやさしい
Ecological

※1 TTV 実績値：お問い合わせください



組合せ例：3セルタイプ

仕様 Specifications	GLP-150 Ssries
加工範囲 Work size	MAXφ150 (6inch) (OP 8inch) 厚み (thickness) 100μm ~ 3000μm
砥石サイズ Grinding stone size	MAX φ300mm (φ200, φ250)
砥石回転数 Rotational frequency of grinding stone	MAX 3000RPM
送り分解能 Feeding resolution	0.01 μm
ワークテーブル Work table	Vacuum chuck
装置寸法 *1 セル Machine dimensions (*per cell)	aprx. W900mm×H2280mm×D1940mm
装置重量 *1 セル Machine weight (*per cell)	aprx. 4000 kg
オプション Option	①LD or ULD ②研削液循環システム grinding lubricant circulating system

※ 製品の仕様・外観・寸法などは、改良の理由により、予告なく変更する場合があります。
Specifications are subject to change without prior notice.



本 社 / 〒634-8580 奈良県橿原市新堂町 313-1
 TEL.0744-24-6608 FAX.0744-24-8352
 URL <http://www.takatori-g.co.jp> E-mail info@takatori-g.co.jp